

Title (en)

Process for mounting the rear of printed circuit

Title (de)

Verfahren zum Bestücken einer Rückwandleiterplatte

Title (fr)

Procédé pour équiper le dos d'un circuit imprimé

Publication

**EP 0690532 A2 19960103 (DE)**

Application

**EP 95109562 A 19950620**

Priority

DE 4423010 A 19940630

Abstract (en)

The system has the knife contacts (2) supported by a plastics holder (1) with their insertion zones aligned with one another, before fitting to the back wiring board (5) via an insertion stamp (7). The holder is removed from the inserted knife contacts by the retraction the insertion stamp. Pref. the knife contacts are positioned relative to one another by a sliding apertured rail (4) on the side of the holder facing the back wiring board, the apertures over-sized relative to the width of the knife contacts, to provide limited positioning tolerance. <IMAGE>

Abstract (de)

Um bei der Bestückung von Rückwandleiterplatten mit Kontaktmessern die Zentrierleisten mehrmals zu verwenden, sind die Kontaktmesser (2, 12) mit ihren Einpreßzonen in lagerichtiger Zuordnung zueinander in einer als Zentrierleiste dienenden Messerhalterung (1, 11) aus Kunststoff eingesetzt. Die in die Messerhalterung (1, 11) eingesetzten Kontaktmesser (2, 12) werden mittels eines Einpreßstempels (7, 17) aus der Messerhalterung (1, 11) in die Rückwandleiterplatte (5, 15) eingepreßt und beim Zurückfahren des Einpreßstempels (7, 17) wird die Messerhalterung (1, 11) von den Kontaktmessern (2, 12) abgezogen. <IMAGE>

IPC 1-7

**H01R 43/20**

IPC 8 full level

**H01R 43/20** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**H01R 43/205** (2013.01 - EP US); **H01R 12/585** (2013.01 - EP US); **Y10S 439/943** (2013.01 - EP US); **Y10T 29/49153** (2015.01 - EP US); **Y10T 29/49222** (2015.01 - EP US)

Cited by

DE29714747U1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0690532 A2 19960103**; **EP 0690532 A3 19990203**; CA 2152895 A1 19951231; JP H0845637 A 19960216; US 5740607 A 19980421

DOCDB simple family (application)

**EP 95109562 A 19950620**; CA 2152895 A 19950628; JP 16261595 A 19950628; US 49286495 A 19950620